

공개특허특1995-0034701

(19)대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)(51) Int. Cl. ⁶
H01L 23/00495(11) 공개번호 특1995-0034701
(43) 공개일자 1995년12월28일(21) 출원번호 특1994-0010938
(22) 출원일자 1994년05월19일(71) 출원인 아남산업 주식회사 황인길
서울특별시 성동구 화양동 151-22 (우 : 133-130)
(72) 발명자 김재동
서울특별시 성동구 송정동 28-29
(74) 대리인 서만규
심사청구 : 있음

(54) 반도체의 리드프레임

요약

본 발명은 반도체의 리드프레임에 관한 것으로서 리드프레임(1)의 타이바(2)에 컴파운드 몰드 접착력을 좋게 한 구멍(3)과, 내부리드(4)에 각각 "



"형상을 형성하며, 탑재판(5)의 외주연부에는 파형 형상을 갖도록 하여 패키지몰드의 접착력을 향상시키고 댄바 커팅시 외부에서 가해지는 충격에 의한 견고성을 높이며 완제품상태에서 내부로 침투되는 수분을 탑재판의 파형 형상에서 억제시켜 마이크로캡을 방지하여 제품의 품질을 높일 수 있게 한 것이다.

대표도

도1

명세서

[발명의 명칭]

반도체의 리드프레임

[도면의 간단한 설명]

제1도는 본 발명의 리드프레임 개략평면도.

본 건은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음

(57)청구의 범위

청구항1

반도체 칩과 인쇄 회로 기판을 연결시켜 주기위한 소재로 사용되는 리드 프레임에 구성함에 있어서, 상기 리드 프레임(1)의 타이바(2)에 컴파운드 몰드 접착력을 좋게한 구멍(3)을 형성하고, 내부리드(4)에는 각각 "



"형상을 형성하며, 탑재판(5)의 외주연부에는 파형형상을 갖도록 한 것을 특징으로 하는 반도체의 리드프레임.

청구항2

제1항에 있어서, 타이바(2)에 형성한 구멍(3)을 "



"형으로 한 것을 특징으로 하는 반도체의 리드프레임.

청구항3

제1항에 있어서, 탑재판(5)의 외주연부에 형성된 형상은 "

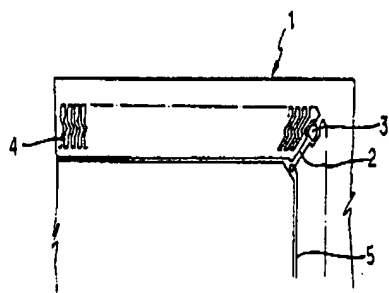


"형으로 한 것을 특징으로 하는 반도체의 리드프레임.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

도면

도면1



KR1994-10938

TITLE OF THE INVENTION: LEAD FRAME OF SEMICONDUCTOR

ABSTRACT:

5 A lead frame (1) of a semiconductor has a hole (3) formed
on a tie bar (2) of the lead frame (1) for excellent compound
mold adhesion force, a shape formed on an internal lead (4),
and a corrugated shape formed on the outer peripheral edge of a
mounting plate (5) to improve the adhesion force of a package
10 mold, increase the durability against an impact applied from
the exterior during cam bar cutting, suppress moisture which
penetrate into the interior in a finished product state at the
corrugated shape of the mounting plate, avoid a micro gap, and
improve the product quality.